



(19)中華民國智慧財產局

(12)設計說明書公告本

(11)證書號數：TW D214778 S

(45)公告日：中華民國 110 (2021) 年 10 月 21 日

(21)申請案號：109303830

(22)申請日：中華民國 109 (2020) 年 07 月 13 日

(51)LOC.(11)Cl.：15-99

(30)優先權：2020/01/22 日本

2020-001044

(71)申請人：日商東京威力科創股份有限公司 (日本) TOKYO ELECTRON LIMITED (JP)
日本

(72)設計人：溫清振 WEN, QINGZHEN (JP)

(74)代理人：何愛文；王仁君

(56)參考文獻：

CN 301238670

JP D1375366

JP D1398162

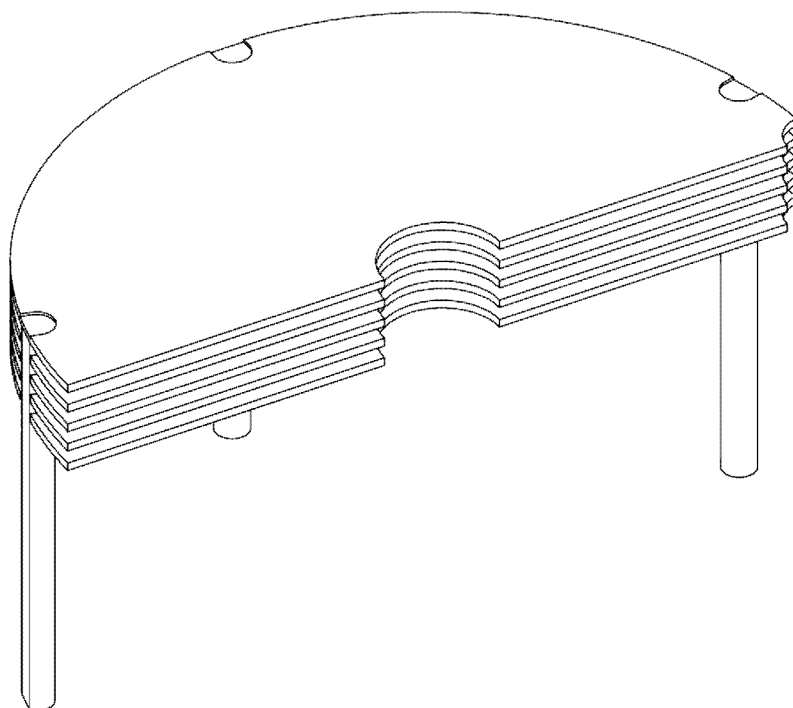
審查人員：蔡俊溢

圖式數：9 共 10 頁

(54)名稱

半導體製造裝置用保溫筒散熱片 (四)

代表圖：



【立體圖】

【設計說明書】

【中文設計名稱】半導體製造裝置用保溫筒散熱片(四)

【物品用途】

【0001】本物品係如「顯示使用狀態之參考剖面圖」所示般地，在製造半導體用晶圓之際，為了調整反應管內置放有晶圓之反應空間內的溫度，而被設置於底部之保溫筒散熱片。在使用之際，如「顯示使用狀態之參考立體圖」所示般地，本物品係與略對稱形狀的保溫筒散熱片組合來加以使用。

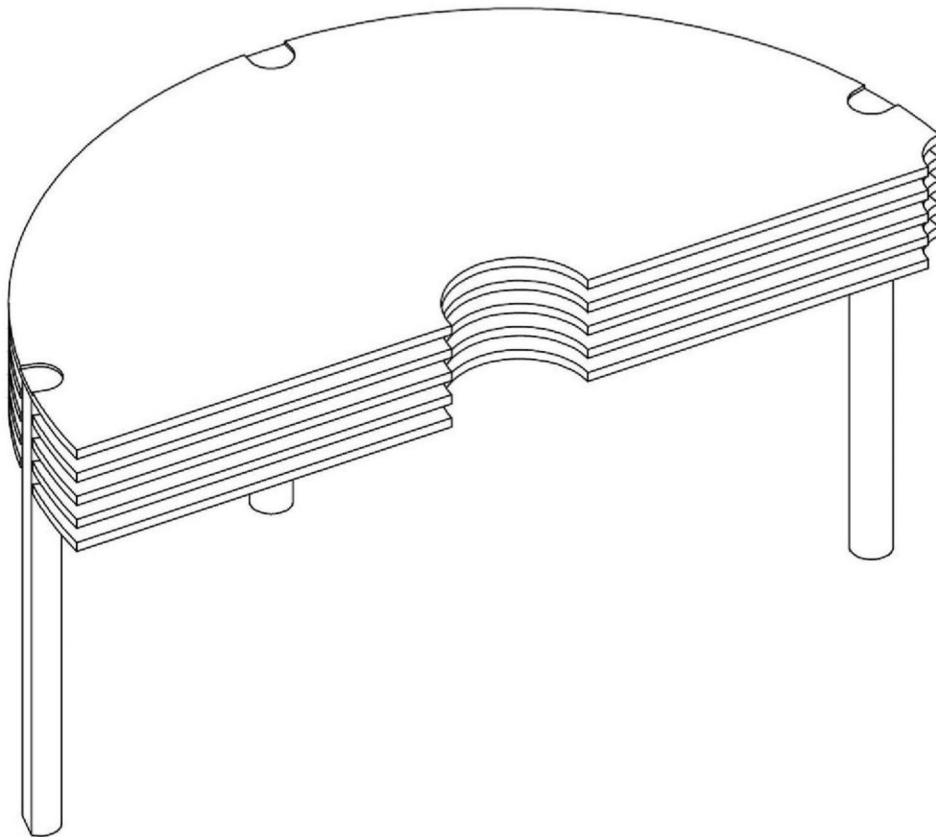
【設計說明】

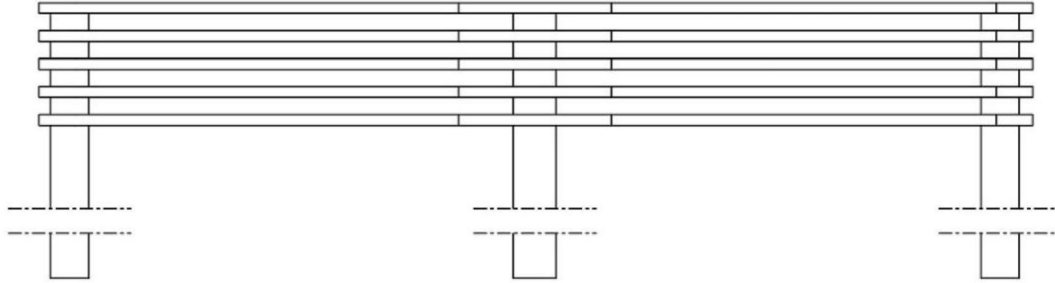
【0002】圖式中，省略的部分在申請書所添附之圖式上為大約35mm。

【0003】顯示使用狀態之參考剖面圖係顯示本設計之半導體製造裝置用保溫筒散熱片被使用的狀態，其中顯示之文字及色彩僅係說明參考用。

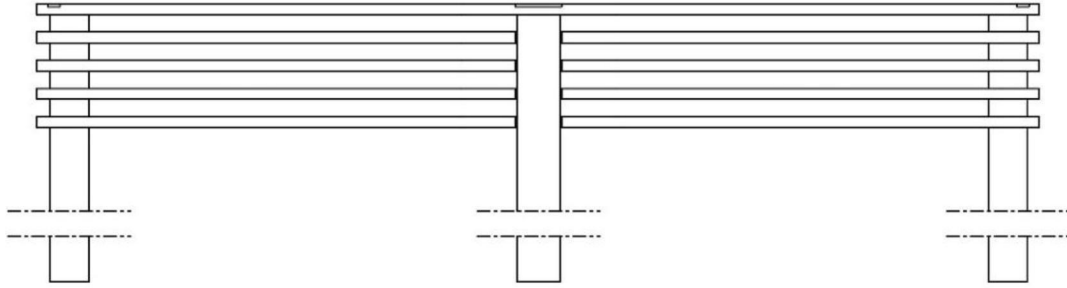
【設計圖式】

(指定代表圖)

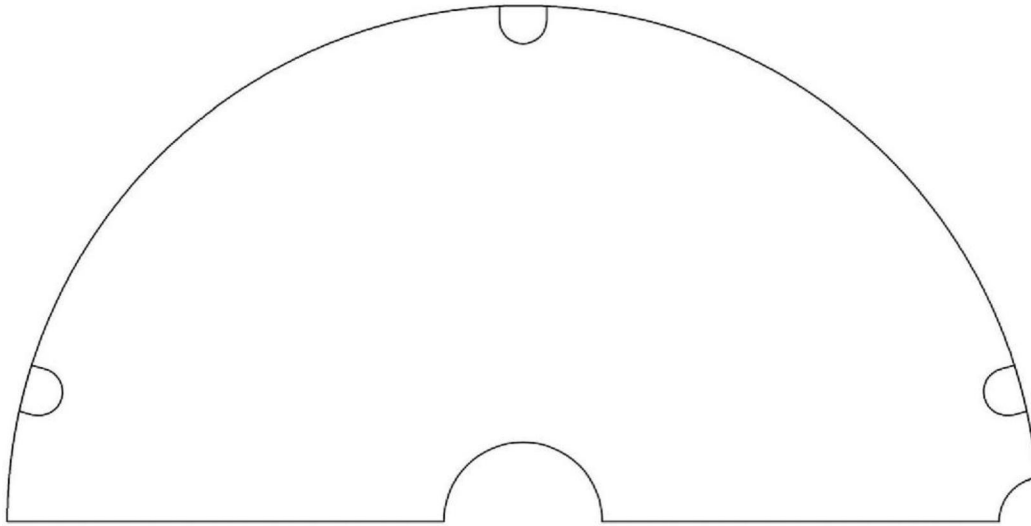
**【立體圖】**



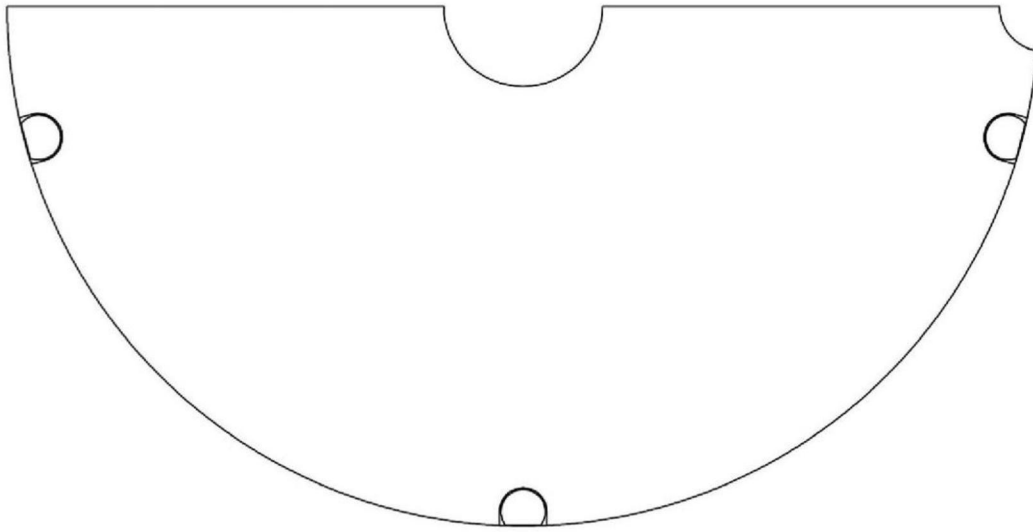
【前視圖】



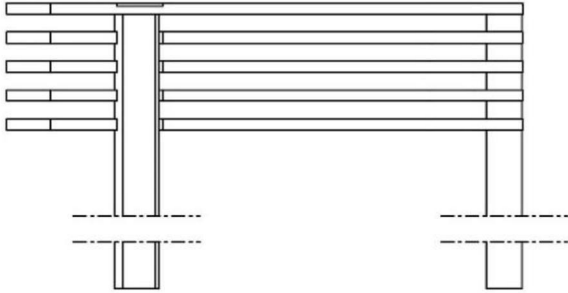
【後視圖】



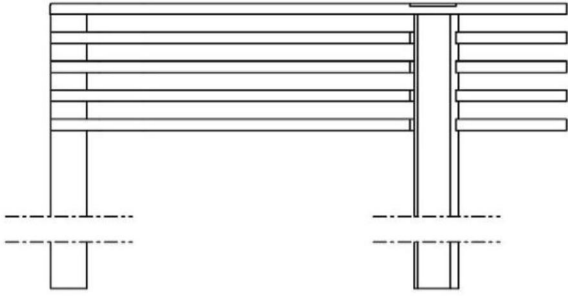
【俯視圖】



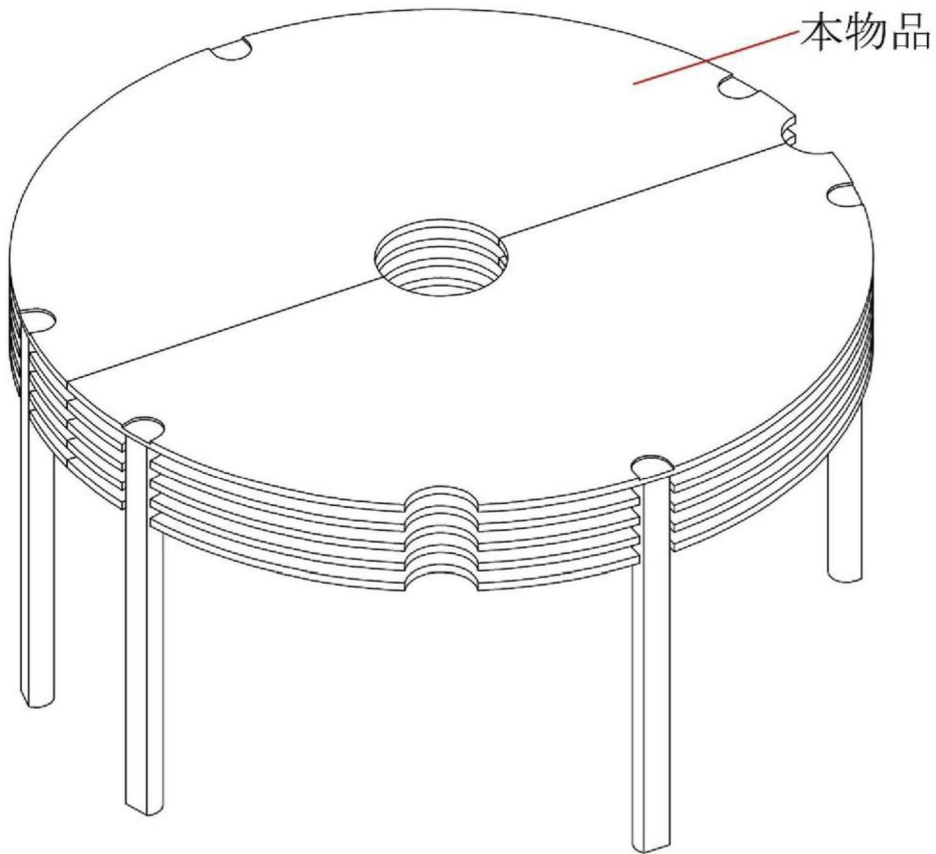
【仰視圖】



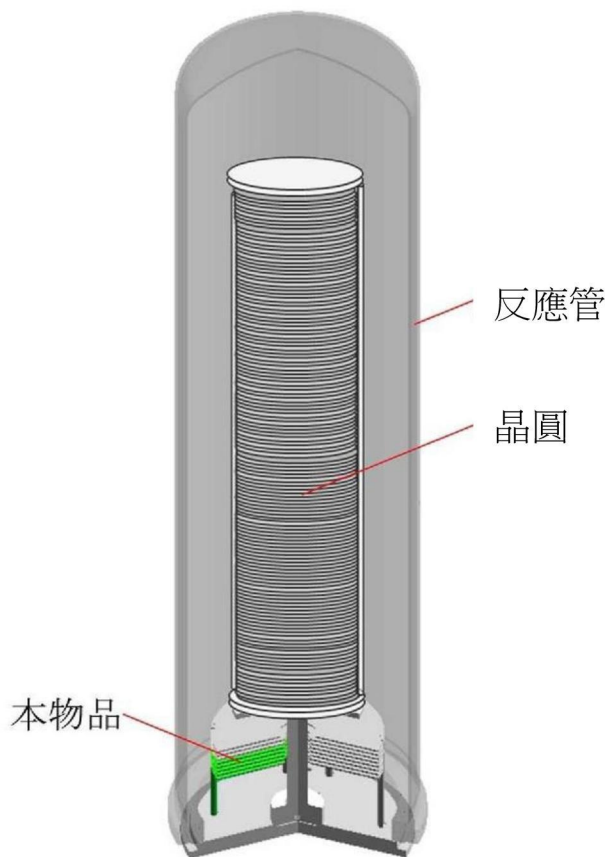
【右側視圖】



【左側視圖】



【顯示使用狀態之參考立體圖】



【顯示使用狀態之參考剖面圖】